ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ, 2023, том 68, № 5, с. 651–657

= ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

УДК 544.344:539.23

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СИНТЕЗА ПЛЕНОК ОКСИДОВ ВАНАДИЯ И ЕГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

© 2023 г. В. А. Шестаков^{а, b,} *, В. А. Селезнев^с, С. В. Мутилин^с, В. Н. Кичай^а, Л. В. Яковкина^а

^аИнститут неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, пр-т Академика Лаврентьева, 3, Новосибирск, 630090 Россия ^bНовосибирский государственный архитектурно-строительный университет, ул. Ленинградская, 113, Новосибирск, 630008 Россия ^cИнститут физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, пр-т Академика Лаврентьева, 13, Новосибирск, 630090 Россия *e-mail: vsh@niic.nsc.ru Поступила в редакцию 01.12.2022 г.

Поступила в редакцию 01.12.2022 г. После доработки 02.02.2023 г. Принята к публикации 03.02.2023 г.

Проведено термодинамическое моделирование и экспериментальное исследование процесса синтеза пленок оксидов ванадия при разных температурах из прекурсора тетракис-этилметиламинованадий $V[NC_3H_8]_4$ в присутствии кислорода и атмосфере аргона. При термодинамическом моделировании использовали метод расчета химических равновесий, основанный на минимизации энергии Гиббса системы. В экспериментальной части работы для синтеза пленок применяли методику атомно-слоевого осаждения. Результаты термодинамического моделирования и экспериментальные данные соответствуют друг другу и могут быть использованы для разработки методик синтеза пленочных покрытий на основе оксидов ванадия.

Ключевые слова: термодинамическое моделирование, атомно-слоевое осаждение, тонкие пленки, диоксид ванадия, пентаоксид ванадия

DOI: 10.31857/S0044457X23600019, EDN: SOHBQS

введение

Диоксид ванадия (VO₂) относится к сильнокоррелированным электронным квантовым материалам, в котором проявляется сверхбыстрый (26 фс) [1] обратимый фазовый переход І рода полупроводник-металл при температурах 68°С [2-5]. При этом в нем происходит структурный фазовый переход: моноклинная (VO₂(M)) кристаллическая решетка преобразуется в тетрагональную $(VO_2(R))$. Фазовый переход в VO₂ сопровождается резким изменением (на несколько порядков по величине) его электрических и оптических характеристик [6-9]. Такие уникальные свойства фазового перехода в VO2 открывают многообещающие возможности для применения этого соединения в ряде новых устройств электроники и фотоники, в частности в нейроморфных системах, резистивных переключателях, элементах памяти, тепловых переключателях, голографических носителях информации, перестраиваемых отражающих зеркалах, энергоэффективных окнах и многих других [10-19].

Отмеченный фазовый переход сопровождается изменением постоянной решетки почти на 1%, что приводит к появлению сильных механических напряжений в материале VO2 с последующим образованием трещин [20]. Поэтому, как правило, VO₂ синтезируется в виде тонких пленок [21-27]. В настоящее время используется широкий набор методов для получения пленок VO₂: золь-гель метод [28], магнетронное распыление [29], химическое осаждение из газовой фазы [30] и др. [31-33]. Наиболее контролируемым, позволяющим синтезировать предельно тонкие однородные слои VO₂, является атомно-слоевое осаждение (АСО) [34]. Суть метода заключается в постоянной подаче инертного газа-носителя в камеру-реактор и раздельному попеременному введению газообразных реагентов в этот поток так, что химические реакции, приводящие к росту пленок, протекают только в хемосорбированных слоях, т.е. с исключением реакций в газовой фазе.

Одна из основных трудностей в синтезе высококачественных пленок VO₂ заключается в наличии в системе V–O многих оксидных форм и различных полиморфов [35]. Ванадий может существовать в четырех степенях окисления: 2+, 3+, 4+, 5+, в результате фазовая диаграмма V–O богата различными оксидами ванадия, которые могут образовываться в пленке. Отдельную задачу представляет формирование кристаллических пленок VO₂ сразу в процессе низкотемпературного ACO, при котором, как правило, получаются кристаллические пленки V₂O₅ или аморфные пленки VO_x, которые с помощью послеростового термического отжига переводятся в VO₂ [36–39].

Цель настоящей работы состояла в определении возможности установления оптимальных условий синтеза пленок VO2 на кремнии методом АСО с использованием в качестве прекурсора тетракис-этилметиламинованадий $V[NC_3H_8]_4$ (TEMAV) на основе термодинамического моделирования. Термодинамическое моделирование используется для расчета содержания конденсированных фаз и состава газовой фазы в системе, находящейся в термодинамическом равновесии. Оно позволяет предсказать образование фаз и фазовых комплексов¹, образующихся в результате процессов синтеза, поэтому широко используется для описания процессов получения покрытий из газовой фазы [40-43]. Например, результаты термодинамического моделирования CVD-процесса в системе Si-B-N-C-H [40] показали возможность образования тех же самых фазовых комплексов, которые экспериментально получены в работе [44]. В работе [43] результаты моделирования не только полностью соответствуют экспериментальным данным, но и позволяют объяснить некоторые особенности синтеза диоксида ванадия.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Методика термодинамического расчета. Равновесный состав газовой фазы и фазовых комплексов определяли посредством минимизации энергии Гиббса системы при заданных Т и Р. В процессе расчета использовали базу данных и стандартное программное обеспечение банка данных по свойствам материалов электронной техники (БНД СМЭТ) [45]. В качестве дополнения применяли термодинамические данные по оксидам, карбидам и нитридам ванадия из [46, 47]. При расчете принимали следующие допущения. Предполагали, что в системе присутствуют конденсированные фазы постоянного состава и равновесный идеальный газ, образованный из молекулярных форм (специй); химический состав системы в зоне осаждения соответствует элементному составу входной газовой смеси, а газовая фаза в зоне осаждения находится в термодинамическом равновесии с конденсированными фазами. В качестве исходной термодинамической информации использовали стандартные термодинамические характеристики индивидуальных веществ: $\Delta_f H_{298}^0, S_{298}^0, C_p^0 = f(T)$, имеющиеся в вышеуказанном банке данных и приведенных выше дополнительных источниках. Из-за отсутствия информации о термодинамических свойствах возможных в системе фаз переменного состава эти фазы не учитывали.

Синтез тонких пленок оксидов ванадия. Тонкие пленки VO_r осаждали на подложках Si(100) и SiO₂/Si методом плазменно-стимулированного атомно-слоевого осаждения (ПС-АСО) с чередующимися импульсами TEMAV в качестве прекурсора ванадия и плазмы Ar/O₂ в качестве окислителя. Процесс осаждения проводили при трех различных температурах подложки (150, 170, 200°С) и давлении 30 Па в реакторе SI ALD LL (Sentech, Германия) [48], оснащенном лазерным эллипсометром для мониторинга процесса АСО в режиме реального времени (ALD-RTM, Sentech). Схема реактора подробно описана в работах [49, 50]. Подложки помещали на массивный заземленный металлический электрод-нагреватель, температуру которого задавали с точностью $\pm 0.1^{\circ}$ С программным ПИД-регулятором. В качестве газа-носителя TEMAV и для продувки камеры реактора использовали Ar высокой чистоты (99.9998%) с расходом 100 ст. см³/мин. Источник с прекурсором и газовые линии его подачи подогревали до температуры 90°С для исключения его конденсации. Через источник плазмы пропускали аргон с расходом 120 ст. см³/мин. Во время этапа плазмы через источник плазмы пропускали кислород (высокой чистоты 99.999%) с расходом 120 ст. см³/мин, а по линии прекурсора продолжал поступать аргон. Плазму генерировали удаленным источником емкостно-связанной плазмы (ССР), так, что в процессе ПС-АСО подложка была расположена отдельно от области генерации плазмы, удалена от высокоэнергетических ионов и ультрафиолетового излучения, которые могли бы привести к повреждению поверхности подложки [49, 50]. Используемый источник ССР работал на частоте 13.56 МГц при мощности плазмы 200 Вт.

Каждый цикл ПС-АСО состоял из четырех этапов: 1) импульс паров прекурсора TEMAV длительностью 80 мс; 2) продувка Ar; 3) импульс кислородной плазмы; 4) продувка Ar. В экспериментах кроме температуры подложки задавали длительность воздействия кислородной плазмой во втором полуцикле осаждения, которая составляла 15 или 60 с. Цикл периодического осаждения

¹ Фазовый комплекс представляет собой совокупность конденсированных фаз, находящихся в равновесии между собой, а также с газовой фазой.



Рис. 1. Содержание конденсированных фаз в фазовом комплексе и молекулярных форм в газовой фазе, образующихся при разложении 1 моля $V(NC_3H_8)_4$.

повторяли до тех пор, пока не достигали желаемой толщины пленки 5 или 30 нм.

Перед загрузкой в реактор подложки химически обрабатывали в смеси H_2SO_4 : $H_2O_2 = 3:1$ в течение 15 мин, промывали в чистой деионизованной воде и высушивали струей чистого сухого воздуха. После загрузки подложек в реактор по линиям плазмы и прекурсора подавали аргон, в реакторе задавали давление 30 Па и в течение 30 мин достигали стабилизации температуры подложки. Перед началом процесса ПС-АСО проводили обработку подложек кислородной плазмой в течение 10 мин при мощности 200 Вт без подачи прекурсора в реактор. Данная обработка способствовала удалению углеродно-органических загрязнений с поверхности подложки. Динамику процесса осаждения, толщину пленок оксидов ванадия, а также скорость их роста за цикл определяли *in situ* методом эллипсометрии.

Характеризация синтезированных пленок. Фазовый состав кристаллической структуры получаемых пленок исследовали методами рентгеновской дифракции и комбинационного рассеяния света (**KPC**). Измерения проводили на дифрактометре Shimadzu XRD-7000 (Cu K_{α} -излучение, Ni-фильтр, $2\theta = 5^{\circ}$ - 60° , шаг 0.03, накопление 1–5 с в режиме θ - 2θ). Индицирование дифрактограмм проводили с использованием программы Search Match и данных картотеки PDF [51]. Спектры КРС регистрировали при комнатной температуре в геометрии обратного рассеяния на спектрометре T64000 Horiba Jobin Yvon со спектральным раз-



Рис. 2. Зависимость характера фаз и фазовых комплексов, образующихся во второй стадии процесса, от величины параметра *n*.

решением 0.5 см⁻¹. Для возбуждения использовали линию Ar⁺-лазера с длиной волны 514.5 нм.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Термодинамическое моделирование. Первая стадия процесса синтеза представляет собой разложение прекурсора TEMAV (V(NC₃H₈)₄). Расчеты проводили для процесса разложения одного моля этого соединения в присутствии аргона при давлении 30 Па, в интервале температур 170–370°С. В процессе расчета учитывали возможность образования следующих конденсированных фаз: V, VN, $VN_{0.465}$, V₂C, VC_{0.88}, C (графит), а также 77 молекулярных форм газовой фазы.

Как показали расчеты, единственным фазовым комплексом, образующимся в данных условиях, является VN + C. На рис. 1 показано содержание нитрида ванадия и графита в фазовом комплексе, а также различных молекулярных форм (H_2 , N_2 , CH_4) в газовой фазе в зависимости от температуры реактора.

Как можно видеть из рис. 1, содержание графита в комплексе уменьшается с понижением температуры синтеза. Учитывая это обстоятельство, а также, что температура разложения $V(NC_3H_8)_4$ около 170°С [36], можно сделать вывод об оптимальности температуры 170°С для данной реакции². Дополнительные расчеты показали, что изменение общего давления в реакторе в ин-

² Чем меньше графита будет в фазовом комплексе, тем меньше кислорода (и времени) потребуется для осуществления второй стадии процесса.



Рис. 3. Содержание фаз в фазовых комплексах, а также молекулярных форм в газовой фазе на второй стадии процесса синтеза в зависимости от величины параметра *n*.

тервале 10–100 Па не меняет тенденций, показанных на рис. 1.

Вторая стадия синтеза предполагает взаимодействие фазового комплекса, образовавшегося на первой стадии, с кислородом. При синтезе в условиях давления 30 Па и температуры 170°С этот комплекс включает в себя 1 моль VN и 5.43 моля графита что соответствует реакции (рис. 1):

$$V(NC_{3}H_{8})_{4} = VN + 5.43C + + 1.5N_{2} + 2.86H_{2} + 6.57CH_{4}.$$
 (1)

Далее расчеты проводили для этого комплекса. В процессе расчета учитывали возможность образования следующих конденсированных фаз: V, V₃O₇, V₆O₁₃, V₈O₁₅, V₇O₁₃, V₆O₁₁, V₅O₉, V₄O₇, V₂O₅, VO₂ (две фазы), V₂O₃, VO, VN_{0.465}, VN, VC_{0.88}, V₂C, C (графит), а также 48 молекулярных форм газовой фазы.

Состав системы, рассматриваемой при моделировании второй стадии синтеза, может быть представлен в виде Ar + $5.43C + VN + nO_2$. На рис. 2 представлена диаграмма, показывающая какие фазы и фазовые комплексы образуются в системе при различных значениях параметра *n* в диапазоне температур 170-370°C и давлении 30 Па. Отметим, что чистому VO₂ отвечает значение *n* = 6.49.

На рис. 3 показано содержание графита, оксидов ванадия, а также двуокиси углерода и кислорода в газовой фазе в зависимости от того же параметра при тех же условиях³. Эта информация позволяет описать механизм второй стадии процесса синтеза как последовательность следующих реакций:

$$C + O_2 = CO_2, \tag{2}$$

$$2VN + 1.5O_2 = V_2O_3 + N_2, (3)$$

$$V_2 O_3 + 0.5 O_2 = 2 V O_2, \tag{4}$$

$$2VO_2 + 0.5O_2 = V_2O_5.$$
(5)

Отметим, что увеличение температуры при второй стадии синтеза приводит к образованию в газовой фазе существенного количества CO в результате реакции равновесия $2CO_2 = 2CO + O_2$. В остальном это, как и изменение давления в реакторе в интервале 10–100 Па, не влияет на механизм процесса.

Экспериментальное подтверждение разложения прекурсора ТЕМАУ при температурах выше 170°С. На рис. 4 приведены данные о толщине осаждаемой пленки, измеренные методом эллипсометрии in situ в режиме реального времени, показывающие реакции хемосорбшии прекурсора ТЕМАУ и лигандного обмена при различных температурах подложки. Пунктирная кривая на рис. 4 показывает изменение температуры подложки от времени. Видно, что впрыск прекурсора ТЕМАУ приводит к резкому увеличению эффективной толщины осаждаемой пленки, которая уменьшается и выходит на насыщение в процессе продувки реактора аргоном. На данном полуцикле происходит хемосорбция молекул TEMAV на поверхности подложки, а также удаление их излишков с поверхности. Импульс кислородной плазмы приводит к уменьшению эффективной толщины пленки, так как происходит отрыв лигандов от хемосорбированных молекул TEMAV и образование оксида ванадия.

Отметим, что в диапазоне температур подложки от 140 до 165°С обработка кислородной плазмой приводит к более значительному уменьшению эффективной толщины пленки по сравнению с более высокими температурами (T > 170°С). Начиная с температуры подложки 170°С, импульс кислородной плазмы оказывает существенно меньшее влияние на уменьшение толщины пленки. Данная закономерность свидетельствует в пользу того, что при температурах подложки 170°С и выше происходит разложение прекурсора TEMAV. Полученные результаты хорошо согласуются с литературными данными [36].

Атомно-слоевое осаждение пленок V_2O_5 и их характеризация. Результаты термодинамического моделирования показали, что V_2O_5 может быть получен при параметре $n O_2 > 6.7$. Для подтвер-

³ Содержание аргона (m(Ar) = 1) и азота ($m(N_2) = 0.5$) в данном процессе остается постоянным и на рис. 2 не показано.



Рис. 4. Динамика изменения толщины пленки в течение шести циклов ПС-АСО в зависимости от температуры синтеза, демонстрирующая реакции хемосорбции TEMAV и лигандного обмена при различных температурах подложки. Толщину пленок измеряли методом эллипсометрии *in situ* в режиме реального времени.

ждения этих расчетов ACO-пленок было проведено при больших концентрациях кислорода в реакторе. На рис. 5 представлены спектры KPC пленок V_2O_5 толщиной 5 нм, выращенных с помощью ПС-ACO на подложках SiO₂/Si при температурах 150, 170 и 200°С. Вертикальными линиями отмечены 8 различимых мод (пиков), характерных для орторомбической фазы V_2O_5 ,





Рис. 5. Спектры КРС пленок оксидов ванадия толщиной 5 нм, синтезированных ПС-АСО на подложках SiO_2/Si при температурах 150, 170 и 200°С. Интенсивный пик от Si подложки при 520.5 см⁻¹ исключен из спектров для наглядности представленных данных. Вертикальными линиями отмечены 8 различимых мод (пиков), характерных для орторомбической фазы V_2O_5 .





Рис. 6. Дифрактограммы пленок оксидов ванадия толщиной 30 нм, синтезированных методом ПС-АСО при температурах 150 и 170°С. Пики, отмеченные на верхней дифракторгамме, относятся к стабильной фазе V_2O_5 .

рис. 6, пленка, синтезированная при температуре 150°С, не имеет пиков, характерных для кристаллических фаз оксидов ванадия. Пленка, синтезированная при температуре 170°С, имеет два пика, характерных для чистой поликристаллической орторомбической фазы V_2O_5 , относящейся к пр. гр. P_{mnn} . Таким образом, проведенные эксперименты по синтезу пленок и их исследованию подтверждают результаты термодинамического моделирования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты термодинамического моделирования демонстрируют, что VO_2 может быть получен лишь в очень узкой области изменения содержания кислорода в исходной смеси, а V_2O_5 формируется при высоком содержании кислорода, что подтверждается полученными экспериментальными данными.

Экспериментально показано, что температура разложения прекурсора TEMAV составляет около 170°С и выше, что согласуется с литературными данными [36]. С помощью комбинационного рассеяния света и рентгенофазового анализа показано, что температура синтеза 170°С и выше приводит к формированию в пленках кристаллической фазы V_2O_5 при высоком содержании кислорода в исходной смеси. Таким образом, результаты термодинамического моделирования находятся в согласии с экспериментальными данными.

ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ

Экспериментальные исследования выполнены в ИФП СО РАН при поддержке Российского научного фонда (проект № 21-19-00873). Работа по термодинамическому моделированию выполнена в ИНХ СО РАН и поддержана Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (проект № 121031700314-5).

БЛАГОДАРНОСТЬ

Авторы благодарят ЦКП "ВТАН" НГУ за проведение измерений спектров КРС и ЦКП "Наноструктуры" за предоставление установки АСО для проведения экспериментов.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Jager M.F., Ott C., Kraus P.M. et al.* // Proc. Natl. Acad. Sci. 2017. V. 114. № 36. P. 9558. https://doi.org/10.1073/pnas.1707602114

- 2. *Morin F.J.* // Phys. Rev. Lett. 1959. V. 3. № 1. P. 34. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.3.34
- Shao Z., Cao X., Luo H. et al. // NPG Asia Mater. 2018. V. 10. № 7. P. 581. https://doi.org/10.1038/s41427-018-0061-2
- Liu K., Lee S., Yang S. et al. // Mater. Today. 2018. V. 21. № 8. P. 875. https://doi.org/10.1016/j.mattod.2018.03.029
- Lu C., Lu Q., Gao M. et al. // Nanomaterials. 2021. V. 11. № 1. P. 114. https://doi.org/10.3390/nano11010114
- 6. *Schlag H.J., Scherber W.* // Thin Solid Films. 2000. V. 366. № 1–2. P. 28. https://doi.org/10.1016/S0040-6090(00)00711-2
- Kana Kana J.B., Ndjaka J.M., Vignaud G. et al. // Opt. Commun. 2011. V. 284. № 3. P. 807. https://doi.org/10.1016/j.optcom.2010.10.009
- Sun J., Pribil G.K. // Appl. Surf. Sci. 2017. V. 421. P. 819.
- https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2016.09.125 9. *Briggs R.M., Pryce I.M., Atwater H.A.* // Opt. Express.
- 2010. V. 18. № 11. P. 11192. https://doi.org/10.1364/oe.18.011192
- 10. *Prinz V.Y., Mutilin S.V., Yakovkina L.V. et al.* // Nanoscale. 2020. V. 12. № 5. P. 3443. https://doi.org/10.1039/C9NR08712E
- 11. *Mutilin S.V., Prinz V.Y., Seleznev V.A. et al.* // Appl. Phys. Lett. 2018. V. 113. № 4. P. 043101. https://doi.org/10.1063/1.5031075
- 12. *Mutilin S.V., Prinz V.Y., Yakovkina L.V. et al.* // CrystEngComm. 2021. V. 23. № 2. P. 443. https://doi.org/10.1039/D0CE01072C
- You Zhou, Ramanathan S. // Proc. IEEE. 2015. V. 103. № 8. P. 1289. https://doi.org/10.1109/JPROC.2015.2431914
- Yang Z., Ko C., Ramanathan S. // Annu. Rev. Mater. Res. 2011. V. 41. № 1. P. 337. https://doi.org/10.1146/annurev-matsci-062910-100347
- 15. *Nakano M., Shibuya K., Ogawa N. et al.* // Appl. Phys. Lett. 2013. V. 103. № 15. P. 153503. https://doi.org/10.1063/1.4824621
- Kats M.A., Blanchard R., Zhang S. et al. // Phys. Rev. X. 2013. V. 3. № 4. P. 041004. https://doi.org/10.1103/PhysRevX.3.041004
- 17. *Rios C., Hosseini P., Wright C.D. et al.* // Adv. Mater. 2014. V. 26. № 9. P. 1372. https://doi.org/10.1002/adma.201304476
- Faucheu J., Bourgeat-Lami E., Prevot V. // Adv. Eng. Mater. 2018. P. 1800438. https://doi.org/10.1002/adem.201800438
- Ke Y., Wang S., Liu G. et al. // Small. 2018. V. 14. № 39. P. 1802025. https://doi.org/10.1002/smll.201802025
- Liu T.-J.K., Kuhn K. CMOS and Beyond. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. https://doi.org/10.1017/CBO9781107337886
- Zhu H.-F., Du L.-H., Li J. et al. // Appl. Phys. Lett. 2018. V. 112. № 8. P. 081103. https://doi.org/10.1063/1.5020930

- Ko C., Yang Z., Ramanathan S. // ACS Appl. Mater. Interfaces. 2011. V. 3. № 9. P. 3396. https://doi.org/10.1021/am2006299
- Qazilbash M.M., Brehm M., Chae B.-G. et al. // Science. 2007. V. 318. № 5857. P. 1750. https://doi.org/10.1126/science.1150124
- 24. Zimmers A., Aigouy L., Mortier M. et al. // Phys. Rev. Lett. 2013. V. 110. № 5. P. 056601. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.110.056601
- Chang Y.J., Yang J.S., Kim Y.S. et al. // Phys. Rev. B. 2007. V. 76. № 7. P. 075118. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.76.075118
- 26. Qazilbash M.M., Tripathi A., Schafgans A.A. et al. // Phys. Rev. B. 2011. V. 83. № 16. P. 165108. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.83.165108
- 27. *Stroud D.* // Phys. Rev. B. 1975. V. 12. № 8. P. 3368. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.12.3368
- Inomata N., Usuda T., Yamamoto Y. et al. // Sensors Actuators A Phys. 2022. V. 346. P. 113823. https://doi.org/10.1016/j.sna.2022.113823
- Li G., Xie D., Zhong H. et al. // Nat. Commun. 2022.
 V. 13. № 1. P. 1729. https://doi.org/10.1038/s41467-022-29456-5
- Yakovkina L.V., Mutilin S.V., Prinz V.Y. et al. // J. Mater. Sci. 2017. V. 52. № 7. P. 4061. https://doi.org/10.1007/s10853-016-0669-y
- Zhang Y., Xiong W., Chen W. et al. // Nanomaterials. 2021. V. 11. № 2. P. 1. https://doi.org/10.3390/nano11020338
- Xue X., Zhou Z., Peng B. et al. // RSC Adv. 2015. V. 5. № 97. P. 79249. https://doi.org/10.1039/C5RA13349A
- 33. Shi R., Shen N., Wang J. et al. // Appl. Phys. Rev. 2019. V. 6. № 1. https://doi.org/10.1063/1.5087864
- 34. Li J., An Z., Zhang W. et al. // Appl. Surf. Sci. 2020. V. 529. P. 147108. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2020.147108
- Brahlek M., Zhang L., Lapano J. et al. // MRS Commun. 2017. V. 7. № 1. P. 27. https://doi.org/10.1557/mrc.2017.2
- Prasadam V.P., Bahlawane N., Mattelaer F. et al. // Mater. Today Chem. 2019. V. 12. P. 396. https://doi.org/10.1016/j.mtchem.2019.03.004
- Bai G., Niang K.M., Robertson J. // J. Vac. Sci. Technol. A. 2020. V. 38. № 5. P. 052402. https://doi.org/10.1116/6.0000353

- Niang K.M., Bai G., Robertson J. // J. Vac. Sci. Technol. A. 2020. V. 38. № 4. P. 042401. https://doi.org/10.1116/6.0000152
- 39. Kozen A.C., Joress H., Currie M. et al. // J. Phys. Chem. C. 2017. V. 121. № 35. P. 19341. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.7b04682
- 40. Шестаков В.А., Косинова М.Л. // Изв. АН. Сер. хим. 2021. Т. 70. № 2. С. 283. https://doi.org/10.1007/s11172-021-3083-9
- Шестаков В.А., Косинова М.Л. // Журн. неорг. химии. 2021. Т. 66. № 11. С. 1585. https://doi.org/10.31857/S0044457X21110155
- 42. Шестаков В.А., Косяков В.И., Косинова М.Л. // Журн. неорган. химии. 2020. Т. 65. № 6. С. 829. https://doi.org/10.31857/S0044457X20060215
- 43. Шестаков В.А., Яковкина Л.В., Кичай В.Н. // Журн. неорган. химии. 2022. Т. 67. № 12. С. 1746. https://doi.org/10.31857/S0044457X22600608
- 44. *Merenkov I.S., Katsui H., Khomyakov M.N. et al.* // J. Eur. Ceram. Soc. 2019. V. 39. № 16. P. 5123. https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2019.08.006
- 45. Титов В.А., Косяков В.И., Кузнецов Ф.А. Проблемы электронного материаловедения. Новосибирск: Наука, 1986.
- 46. *Kang Y.-B.* // J. Eur. Ceram. Soc. 2012. V. 32. № 12. P. 3187.

https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2012.04.045

- 47. *Barin I.* Termodynamical Data of Pure Substances. N.Y., 1989.
- 48. Mahmoodinezhad A., Janowitz C., Naumann F. et al. // J. Vac. Sci. Technol. A. 2020. V. 38. № 2. P. 022404. https://doi.org/10.1116/1.5134800
- Henkel K., Gargouri H., Gruska B. et al. // J. Vac. Sci. Technol. A Vacuum, Surfaces, Film. 2013. V. 32. № 1. P. 01A107. https://doi.org/10.1116/1.4831897
- 50. *Haeberle J., Henkel K., Gargouri H. et al.* // Beilstein J. Nanotechnol. 2013. V. 4. № 1. P. 732. https://doi.org/10.3762/bjnano.4.83
- Powder diffraction Files Inorganic Phases. International Centre for Diffraction Data, Pennsylvania, USA, 2010
- Ureña-Begara F., Crunteanu A., Raskin J.P. // Appl. Surf. Sci. 2017. V. 403. P. 717. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2017.01.160